

公司沿革

年 月	重要紀事
民國 94 年 9 月	公司登記成立於台北市，實收資本額新台幣 100 萬元。
民國 94 年 12 月	申請獲准進入新竹科學工業園區，公司正式成立。聯笙電子以技術股 4,000 萬元做價，現金增資 7,900 萬元，實收資本額新台幣 1 億 2,000 萬元。
民國 95 年 3 月	發表世界上第一款以 CMOS 研製之衛星用 4X2 矩陣晶片 A7531。
民國 97 年 9 月	取得 ISO 9001:2008 品質認證。
民國 99 年 3 月	sub_1GHz 系列晶片成功打入汽車市場。
民國 99 年 3 月	2.4GHz 系列晶片成功打入體感遊戲市場。
民國 99 年 3 月	笙科電子大陸深圳代表處正式成立。
民國 99 年 3 月	曾三田先生當選為笙科電子董事長。
民國 99 年 5 月	溢價增資，增資後實收資本額為新台幣 2 億 3,382 萬元。
民國 99 年 8 月	遷址至新竹科學工業園區力行一路一號一樓矽導研發中心。
民國 99 年 9 月	sub_1GHz 系列晶片成功打入無線抄表市場。
民國 99 年 11 月	2.4GHz 系列晶片成功打入物聯網市場。
民國 100 年 6 月	盈餘轉增資，增資後實收資本額為新台幣 3 億 3,539 萬元。
民國 100 年 8 月	2.4GHz 標準型 Zigbee 晶片成功打入物聯網市場。
民國 100 年 9 月	溢價增資，增資後實收資本額為新台幣 3 億 9,539 萬元。
民國 100 年 12 月	笙科電子大陸上海代表處正式成立。
民國 100 年 12 月	經行政院金融監督管理委員會證券期貨局核准股票補辦公開發行。
民國 101 年 4 月	成立薪資報酬委員會。
民國 101 年 5 月	員工紅利轉增資及員工認股權憑證增資，增資後實收資本額為新台幣 4 億 934 萬元。
民國 101 年 6 月	登錄興櫃股票。
民國 102 年 1 月	發表第五代 Single LNB 衛星接收器晶片 A7833。
民國 102 年 1 月	發表第五代 4x1 DiSEqC LNB Switch A7511。
民國 102 年 2 月	發表第四代內建可達 20dBm PA 4Mbps 高速 2.4GHz TRx A7190。
民國 102 年 2 月	發表第五代 4mA 低接收電流 sub_1GHz TRx A7129/A7139。
民國 102 年 5 月	上櫃股票掛牌。
民國 102 年 6 月	上櫃前現金增資，增資後實收資本額為新台幣 4 億 5,480 萬元。
民國 103 年 2 月	藍芽低功耗系列晶片獲 Bluetooth BQB 認證，並發表臺灣第一顆藍芽低功耗晶片。
民國 103 年 3 月	發表一系列的新一代高整合 RF SoC，如無線聲音傳輸 A8101，藍芽低功耗 A8105，sub_1GHz SoC A9108，加深物聯網的布局。
民國 103 年 8 月	發表新一代高整合 Zigbee/Rf4CE 無線射頻收發 SoC 晶片 A8153。
民國 103 年 8 月	發表 S-band Down Converter 衛星接收晶片 A7837。
民國 103 年 8 月	發表新一代高整合 sub_1GHz 無線 RF SoC 晶片 A9112。
民國 103 年 8 月	發表新一代高整合 sub_1GHz 無線晶片 A7112。

年月	重要紀事
民國 103 年 8 月	發表 2.4GHz 2Mbps 無線收發 SoC 晶片 A8125。
民國 103 年 8 月	發表 2.4GHz 10dBm 2Mbps 無線收發 SoC 晶片 A8137。
民國 103 年 9 月	發表 2.4GHz 500Kbps 無線收發 SoC 晶片 A8106。
民國 104 年 2 月	發表 2.4GHz 單向 2Mbps 無線發射 SoC 晶片 A8325。
民國 104 年 3 月	發表 2.4GHz 無線收發 USB SoC 晶片 A8108。
民國 104 年 4 月	發表藍芽低功耗(Bluetooth LE)無線收發 SoC 晶片 A8107。
民國 104 年 4 月	發表低接收電流 sub_1GHz 無線 RF SoC A9129/A9139。
民國 104 年 8 月	推出內建 19.5dBm PA 高速 6Mbps 2.4GHz FSK 無線射頻收發晶片 A7196。
民國 104 年 6 月	盈餘轉增資，增資後實收資本額為新台幣 5 億 1,045 萬元。
民國 104 年 8 月	發表藍芽低功耗(Bluetooth LE) SiP 晶片 A8107 SiP。
民國 104 年 8 月	發表 2.4GHz 無線遙控玩具車 RF IC A7216/A7316。
民國 104 年 8 月	發表高整合 2.4GHz 無線語音 SoC 晶片 A8100。
民國 104 年 8 月	發行限制員工權利新股，發行後實收資本額為新台幣 5 億 2,045 萬元。
民國 104 年 9 月	發表新一代 整合型高精確度 ADC 無線 sub_1GHz RF SoC A9109。
民國 104 年 9 月	推出新一代 4x4 整合型 LNB SWITCH 晶片 A7544。
民國 104 年 11 月	發表 LCD 顯示無線 SoC 系列- A8525/A8526。
民國 105 年 1 月	發表 5.8GHz 新產品線無線射頻收發晶片 A5130。
民國 105 年 1 月	推出 sub_1GHz DSSS 展頻無線收發晶片 A7159。
民國 105 年 1 月	溢價增資，增資後實收資本額為新台幣 5 億 8,019 萬元。
民國 105 年 3 月	A8107 SiP 獲得 2016 年度大中華 IC 設計成就獎。
民國 105 年 8 月	發表 5.8GHz 新產品無線射頻收發晶片 A5125。
民國 105 年 8 月	推出新一代 2x4 整合型 LNB SWITCH 晶片 A7524。
民國 105 年 9 月	發表新一代內建 ARM® Cortex®-M0 藍芽低功耗(Bluetooth LE) SoC 晶片 A8107M0。
民國 105 年 10 月	發表新一代高整合 sub_1GHz 無線語音 SoC 系列晶片 A9101。
民國 105 年 10 月	發表新一代高整合 2.4GHz 無線音頻 SoC 晶片 A8102。
民國 105 年 12 月	發表 DSSS 展頻調變 sub_1GHz 無線 RF SoC 晶片 A9159。
民國 106 年 3 月	發表具 LCD 顯示功能 BLE 晶片系列 A8507/A8508。
民國 106 年 3 月	發表具 LCD 顯示功能 sub_1GHz A9508。
民國 106 年 3 月	推出新一代高隔離 4x2 LNB SWITCH 晶片 A7540/A7539。
民國 106 年 3 月	5.8GHz 無線晶片 A5130/A5125 獲得 2017 年度大中華 IC 設計公司成就獎：年度最佳 RF 無線 IC。
民國 106 年 6 月	發表新一代 13dBm 2.4GHz 2Mbps 無線收發 SoC 芯片 A8137M0。
民國 106 年 9 月	遷址至新竹縣竹北市台元科技園區。
民國 107 年 3 月	發表藍芽低功耗(Bluetooth LE) SoC 晶片 A8115。